

产品概述

EMC-i.MX6-SBC是一款以NXP(Freescale) Cortex-A9 i.MX6DL 双核处理器为核心的嵌入式工业控制主板，集成度高，接口丰富。采用开放式Android 操作系统，支持Android4.4.2/Android5.1。支持LVDS+HDMI 显示接口，支持独立多显。

适用于医疗卫生、工业自动化、机器人、智能家居、物联网、信息系统和金融设备、自助终端、道路监控等多个行业领域。



参数配置

型号	EMC-i.MX6-SBC	
处理器	CPU	NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 双核 1.0GHz
内存	技术	DDR3 1066MHz 载板 DDR3 1GB
存储	形式	板载 8G Nand Flash, 2GB~32GB TF 卡
图像	LVDS	1 路双八 LVDS
	HDMI	1 路 HDMI
以太网	速率	10M/100M/1000M bps
WDT	CPU 自带	1 路 CPU 内部集成看门狗
IO	串口	4xRS232 其中 3 路为标准 DB9， 1 路为插针（流控可选）
	USB 接口	4 路为标准的 USB2.0 A 型口，1 路为插针
	Audio	1路SPEAKER接口，可外接8Ω5W喇叭， 1路2.0HP输出，1 路单通道 MIC 输入
	Mini PCIE	1 路 Mini PCIE 接口，支持市场主流 4G 模块 (中兴、华为、诺控、移远等)
	SIM 卡座	1 路抽屉式卡座（配合 3G/4G 模块使用）
	SD 卡	1 路 TF 卡座，支持 2GB~32GB
	GPIO	13 路 GPIO 板内插针
	SATA	/
	CAN	/
WIFI/BT	可选	路板载 WIFI/BT 模块，带 AP 热点功能， 速率54M/150Mbps
3G/4G	可选	Mini PCIE/LCC 可选
操作系统	Android	Android4.4.2/Android5.1
电源	输入电压范围	DC 12V/5A (8V~24V)
尺寸		148mm x 109.7mm x 29.8mm
环境	工作温度	-20℃~60℃
	工作湿度	5%~95%相对湿度，无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random 工作状态下
EMC		CE/FCC Class B

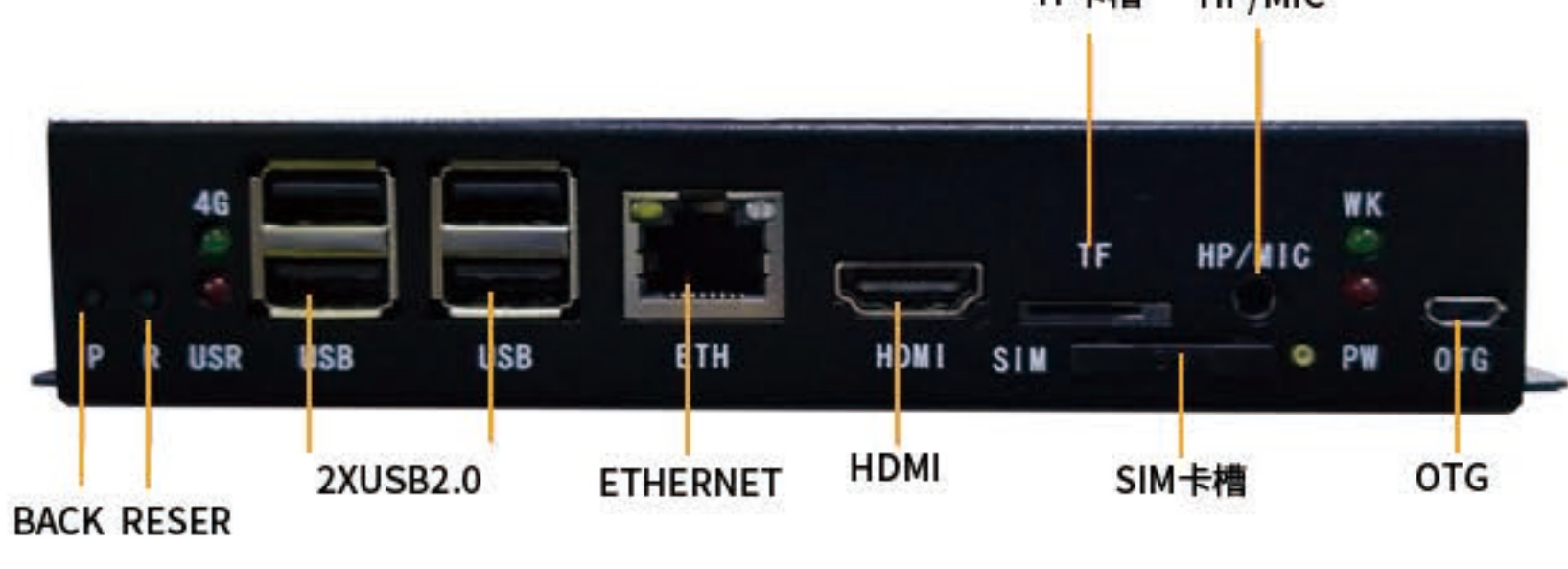
功能特点



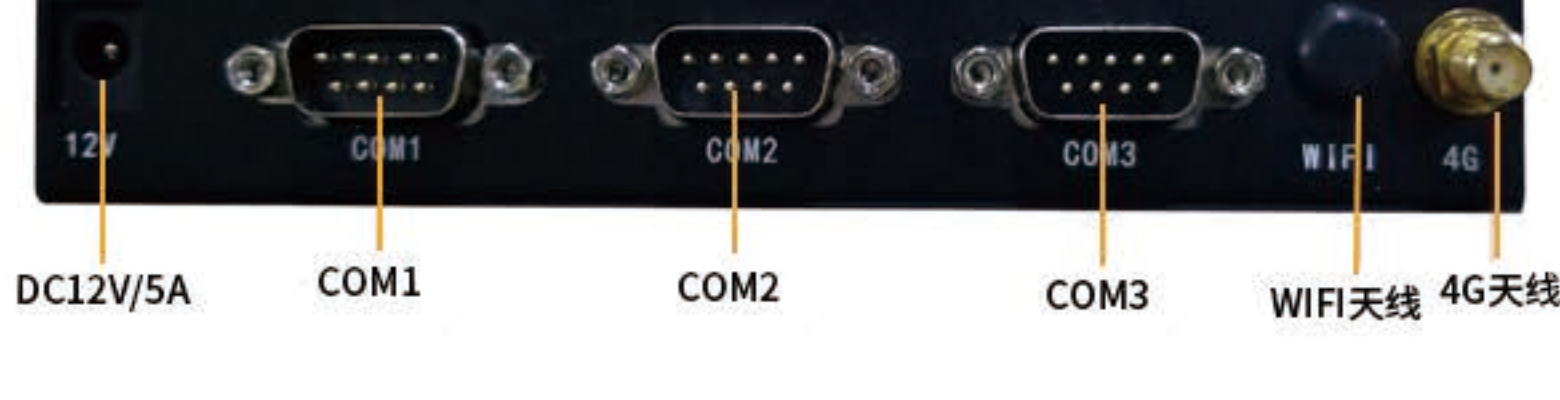
- 基于 FREESCALE CORTEX A9 I.MX6DL 双核处理器
- 支持 1GB DDR3 内存，8GB FLASH，支持 SD 存储
- 支持 1X HDMI，1X LVDS 多种显示接口，支持独立多显
- 提供 5X COM（1X RS485，4X RS232），4X USB2.0，1X USB OTG，1X LAN，板载 USB WIFI（可选），1X HP，1X SPK，支持 5W 功放
- 1X SIM 卡插座，可支持 3G/4G 网络
- 采用开放式 ANDROID 操作系统，稳定、易维护

接口展示

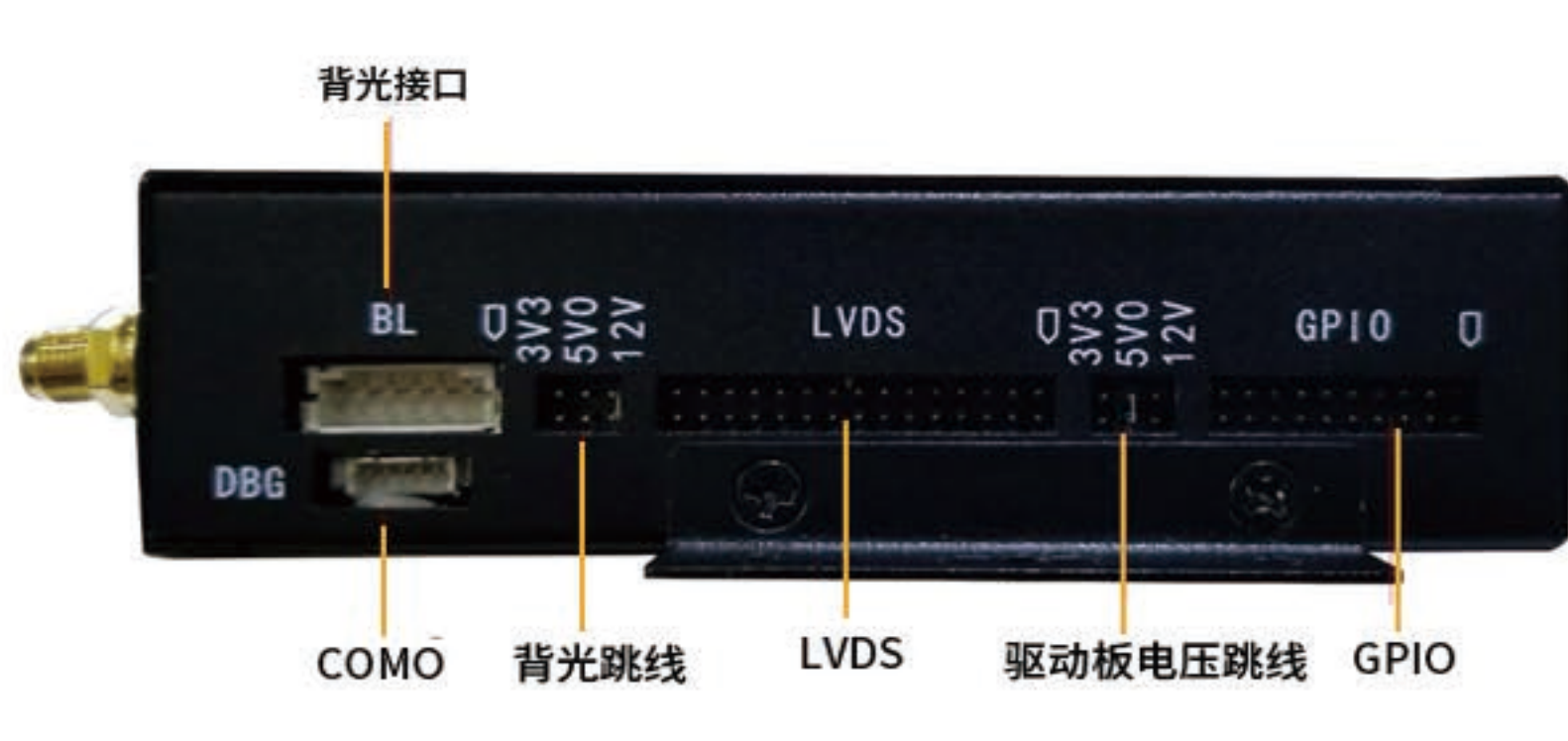
● 正面



● 背面



● 左侧面



● 右侧面

